

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第6部門第1区分
 【発行日】平成26年8月7日(2014.8.7)

【公開番号】特開2012-251964(P2012-251964A)
 【公開日】平成24年12月20日(2012.12.20)
 【年通号数】公開・登録公報2012-054
 【出願番号】特願2011-126954(P2011-126954)
 【国際特許分類】

G 0 1 K 7/00 (2006.01)

G 0 1 K 1/14 (2006.01)

【F I】

G 0 1 K 7/00 3 8 1 L

G 0 1 K 1/14 L

【手続補正書】

【提出日】平成26年6月23日(2014.6.23)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

一対の加熱部を有する加熱装置の温度検出方法であって、
 前記一対の加熱部の間に断熱部材を設置する設置段階と、
 前記一対の加熱部が放熱している状態で、前記断熱部材に対して前記一対の加熱部の少なくとも一方の側において温度を検出する検出段階と
 を備える温度検出方法。

【請求項2】

前記検出段階では、前記断熱部材の前記一方の加熱部側の温度と、前記断熱部材の他方の前記加熱部側の温度とを検出する請求項1に記載の温度検出方法。

【請求項3】

前記検出段階の後、前記断熱部材の少なくとも前記一方の加熱部側に配置された温度検出部の位置を変更する変更段階を有し、
 前記変更段階の後、再度、前記検出段階を実行する
 請求項1または2に記載の温度検出方法。

【請求項4】

前記温度検出部は、第1温度センサ及び第2温度センサを有し、
 前記変更段階では、位置変更後の前記第1温度センサが、位置変更前の前記第2温度センサと同じ位置となる
 請求項3に記載の温度検出方法。

【請求項5】

前記一対の加熱部のそれぞれは、複数であって、
 前記断熱部材と少なくとも前記一方の加熱部との間に配置された温度検出部は、少なくとも加熱部の数と同数の温度センサを有し、
 複数の加熱部のそれぞれに対応して、複数の温度センサが一対一で配置される
 請求項1から4のいずれか1項に記載の温度検出方法。

【請求項6】

前記少なくとも一方の加熱部側に配置された温度検出部と、前記断熱部材との位置関係

を反転させる段階を
更に含む請求項 1 から 5 のいずれか 1 項に記載の温度検出方法。

【請求項 7】

前記検出段階では、前記断熱部材の少なくとも前記一方の加熱部側に配置された温度検出部が真空状態で温度を検出する請求項 1 から 6 のいずれか 1 項に記載の温度検出方法。

【請求項 8】

請求項 1 から 7 のいずれか 1 項に記載の温度検出方法によって温度を検出する段階と、
前記加熱装置において、重ね合わせた一对の基板を前記一对の加熱部によって加熱して、前記一对の基板を貼り合わせる段階と
を含む基板貼り合わせ方法。

【請求項 9】

検出された温度に基づいて、前記一对の加熱部の温度を制御する請求項 8 に記載の基板貼り合わせ方法。

【請求項 10】

前記一对の基板を貼り合わせた後、検出された温度に基づいて制御された冷却部によって前記一对の基板を冷却する段階を更に含む請求項 8 または 9 に基板貼り合わせ方法。

【請求項 11】

前記一对の基板を搬送部により前記加熱装置に搬送する段階を更に含み、
前記断熱部材の少なくとも前記一方の加熱部側に配置された温度検出部及び前記断熱部材は、前記搬送部により前記加熱装置に搬送される請求項 8 から 10 のいずれか 1 項に記載の基板貼り合わせ方法。

【請求項 12】

少なくとも一方の側と他方の側とから加熱された状態での温度を検出するための温度検出装置であって、
断熱部材と、
前記断熱部材の前記一方の側に設けられた第 1 温度検出部と
を備える温度検出装置。

【請求項 13】

前記断熱部材の前記他方の側に設けられた第 2 温度検出部を更に備える請求項 12 に記載の温度検出装置。

【請求項 14】

前記温度検出部は、温度センサと、前記温度センサを保持し、位置検出用のマークが形成された温度検出基板とを有する請求項 12 または 13 に記載の温度検出装置。